



Research and
Development Center

手机需求放缓，再谈半导体投资逻辑

电子行业周报

2021年05月09日

证券研究报告

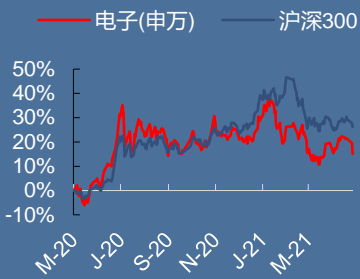
行业研究

行业周报

电子

投资评级 看好

上次评级 看好



数据来源：万得，信达证券研发中心

方 竞 电子行业首席分析师

执业编号：S1500520030001

邮 箱：fangjing@cindasc.com

李 少 青 电子行业分析师

执业编号：S1500520080004

邮 箱：lishaoqing@cindasc.com

刘 志 来 研究助理

邮 箱：liuzhilai@cindasc.com

童 秋 涛 研究助理

邮 箱：tongqiutao@cindasc.com

信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO., LTD

北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

邮编：100031

手机需求放缓，再谈半导体投资逻辑

2021年5月9日

本期内容提要：

本周五半导体板块普跌，引发市场对安卓链订单的担忧。我们于前期深度报告中便已提示过手机市场需求减弱的趋势，但对半导体板块的投资机遇依旧坚定看好。在此我们重申手机市场需求及半导体投资逻辑如下：

- **手机市场需求放缓，库存周期为主因**：通过产业链跟踪可见，自2月中旬起，手机市场需求持续放缓，回归常态水平。**国内市场方面**，BCI高频数据显示手机需求持续走低，4月末第17周（4.19-4.25）国内手机销量462.6万台，同比下降21.8%。同时据产业链调研，今年“五一”长假期间，国内市场亦有16%的下滑。**海外市场方面**，疫情原因影响了部分国家的出货表现，但由于去年Q2同样为疫情爆发期，所以基数偏低，同比表现尚可。

我们认为，库存周期对手机市场短期影响较大。去年Q4，高中低端SOC全面缺货，参考舜宇光学的月度模组出货数据，11、12月的模组出货量降至4000万+。同比降幅在20%以上，环比亦有显著滑落。

由于4G中低端芯片主要集中在10nm等相对不甚紧缺的制程，所以**进入2021年，中低端机型的套片供给有了快速改善**，目前海外市场仍主要采用4G SOC，所以Q1开启补库存；而国内市场方面，有较多H代理商于Q1转投OVM，所以同样有补库存需求。受此推动，一季度的舜宇模组出货量亦有显著提升，其中1、2月出货量均在6000万+，创历史新高。

当下，**海内外手机渠道库存已基本补齐，因此短期内订单有所放缓**。此外，我们在前期《追根溯源，探讨缺货的危与机》深度报告中便已提示，**当前各大手机厂的规划加总，一定程度上超整体市场需求量**。所以补库存周期结束后，各大厂商规划也开始重回理性，但旗舰机SOC及电源芯片依旧严重缺货，**结构性缺货依旧持续**。

- **市场错杀之下，半导体投资机遇凸显**：我们前期着力推荐的晶丰明源、士兰微等优质标的，在上周五跌幅较大。系因市场担心需求放缓使得缺芯趋势反转，而产生恐慌性情绪。

不过我们依旧看好半导体投资机遇，由于8寸需求中有33%来自于汽车，当下汽车IGBT、MOSFET等需求依旧旺盛，渠道库存水位偏低，所以**手机市场需求放缓对功率及模拟的供给格局几无影响，长期缺货将持续**。

而对于韦尔股份、卓胜微等龙头而言，公司抢份额的国产替代逻辑更甚于行业景气度，其 α 属性远强于行业 β 属性，本次大跌实属错杀。总而言之，短期波动不扰长期景气度向好，且半导体板块投资并非只关注一两个季度的景气度，更重要的是伴随优质标的长跑。

- **投资评级**：虽然手机需求放缓，但我们认为在新能源汽车、IOT等新兴需求驱动下，半导体景气度仍有长达5-10年以上的长需求支撑，短期波动不改景气度向好趋势。而如模拟、功率等因下游需求分散，手机需求减弱对其影响较小。且对国内IC设计公司而言，国产替代逻辑更甚于下游景气度，业内公司不断打入本土供应链仍是未来核心成长主线。**建议关注：半导体设计**：韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、思瑞浦、晶丰明源、晶晨股份、富瀚微；**功率半导体**：新洁能、士兰微、华润微、中车时代电气、斯达半导、闻泰科技。
- **风险因素**：市场竞争加剧；疫情持续，影响需求；技术渗透不及预期；中美贸易纠纷风险，半导体景气度下行风险。

目录

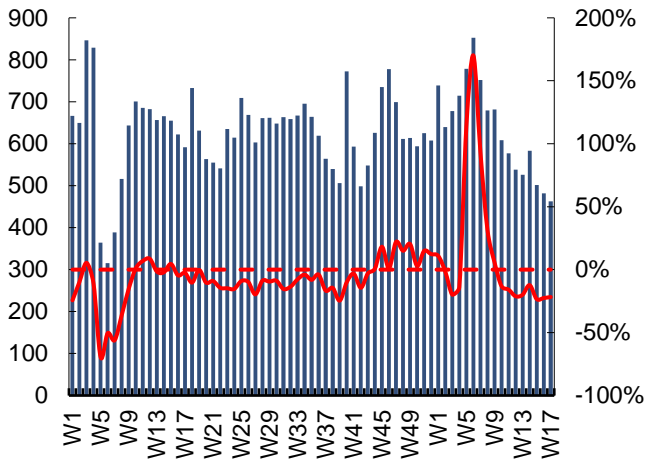
附录一：上周市场回顾.....	5
附录二：上周科技新闻回顾.....	6
附录三：近期重要行业数据整理更新.....	10
附录四：上市公司重要公告和未来大事提醒.....	12

表目录

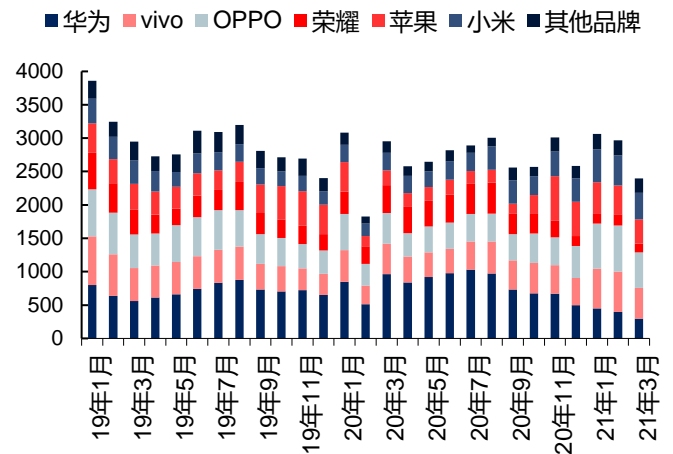
表 1: 重要指数和价格变化.....	5
---------------------	---

图目录

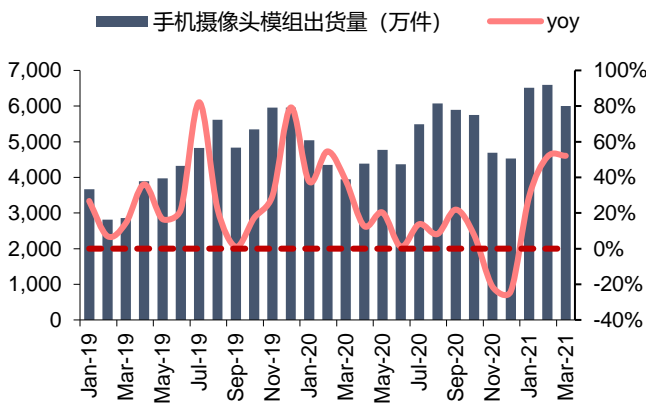
图 1: 20-21 年国内市场手机周度销量 (万台)	4
图 2: 20-21 年国内市场月度销量数据 (万台)	4
图 3: 舜宇光学手机摄像头模组出货量 (万件)	4
图 4: 全球智能手机出货量 (百万台)	4
图 5: 电子行业子板块周涨跌幅 (%)	5
图 6: 电子行业个股周涨跌幅前五后五 (%)	5
图 7: 4Q19-2Q21 全球 NB 出货量变化与预测.....	10
图 8: 4Q19-2Q21 全球 Chromebook 出货量变化与预测.....	10
图 9: 全球各区域半导体设备市场比重.....	10
图 10: 欧洲 30 年来半导体制造产能全球占比.....	10
图 11: 全球各区域封测市场比重.....	10
图 12: 1Q21 全球智能手机出货 Top 5(百万支).....	10
图 13: 全球 Fabless 厂商营收占比趋势.....	11
图 14: 全球 Fabless 厂商及 IDM 厂商营收增速对比.....	11

图 1：20-21 年国内市场手机周度销量（万台）


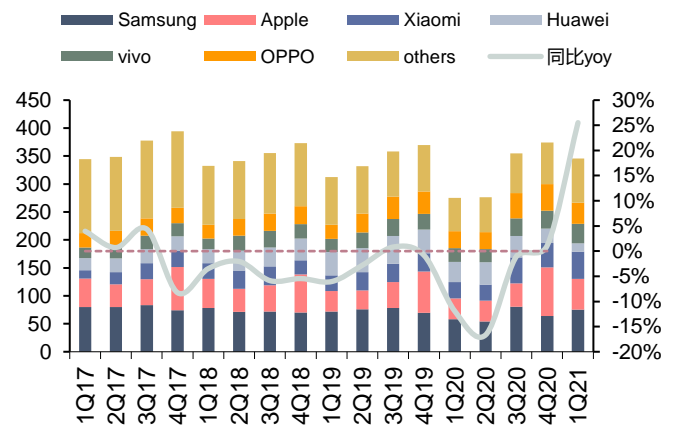
资料来源：BCI，信达证券研发中心

图 2：20-21 年国内市场月度销量数据（万台）


资料来源：BCI，信达证券研发中心

图 3：舜宇光学手机摄像头模组出货量（万件）


资料来源：Wind，信达证券研发中心

图 4：全球智能手机出货量（百万台）


资料来源：IDC，信达证券研发中心

附录一：上周市场回顾

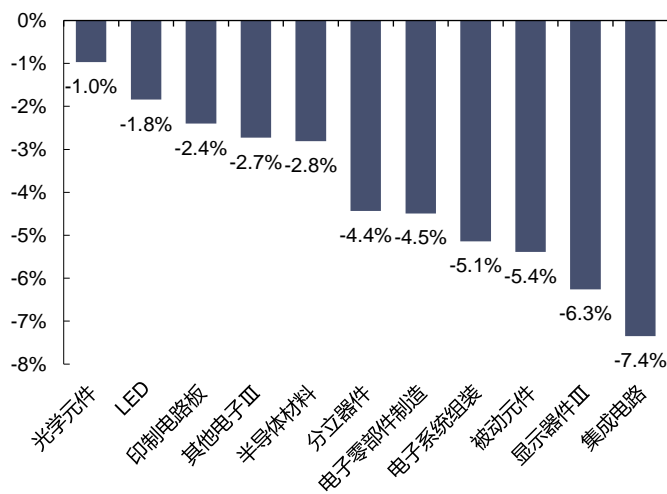
电子板块上周下跌 5.1%，跑输沪深 300 指数 2.6 个百分点。年初至今电子板块下跌 7.0%，跑输沪深 300 指数 2.9 个百分点。上周电子行业子版块涨幅分别为光学元件-0.97%，LED -1.84%，印制电路板-2.40%，其他电子 III-2.73%，半导体材料-2.81%，分立器件-4.43%，电子零部件制造-4.49%，电子系统组装-5.14%，被动元件-5.39%，显示器件 III-6.26%，集成电路-7.35%。就个股而言，上周涨幅位于前列的分别是国科微 10.3%，宝明科技 10.2%，宇瞳光学 9.8%，贤丰控股 8.1%，伟时电子 7.4%。

表 1：重要指数和价格变化

全球股指	指数	周度涨跌幅	年初至今涨跌幅	原材料	价格	涨跌幅
沪深 300	4996.1	-2.5%	-4.1%	LME 铝	2532.0	5.6%
上证综指	3418.9	-0.8%	13.6%	LME 铜	10412.5	6.0%
中小板指	8971.3	-3.2%	11.3%	DCE 塑料	8475.0	4.6%
创业板指	2910.4	-5.9%	6.7%	LME 镍	18070.0	2.2%
道琼斯	34777.8	2.7%	10.4%	LME 锡	29870.0	4.1%
SOX	3112.0	0.1%	12.3%	LME 锌	3025.5	3.4%
纳斯达克	13752.2	-1.5%	15.0%	人民币汇率		
A 股电子	4400.8	-5.1%	-7.0%	美元	6.468	0.01%
恒生科技	20339.4	-3.7%	-3.2%	欧元	7.800	-0.50%
台湾加权	17285.0	-1.6%	17.3%	100 日元	5.929	-0.16%
台湾 IT	24110.2	-1.8%	16.4%	新台币对美元	27.755	-0.33%

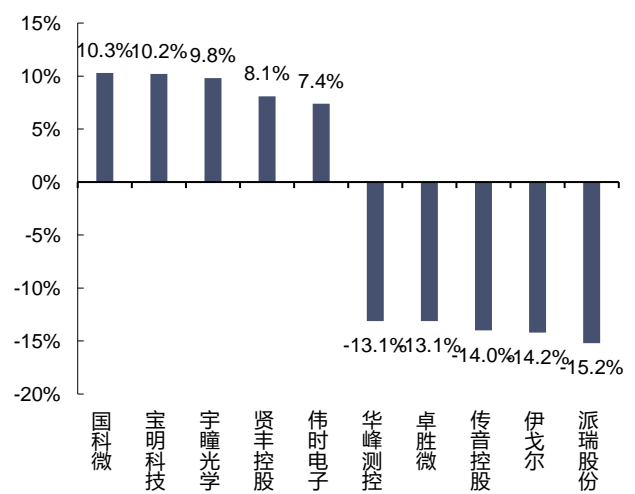
资料来源：Wind，信达证券研发中心

图 5：电子行业子板块周涨跌幅（%）



资料来源：Wind，信达证券研发中心

图 6：电子行业个股周涨跌幅前五后五（%）



资料来源：Wind，信达证券研发中心

附录二：上周科技新闻回顾

1、消费电子

NEC：面部识别系统将时间缩短至 20 分之 1

NEC 开发出了利用基于人工智慧 (AI) 的面部识别大幅缩短识别时间的技术。据称最多可缩短为 20 分之 1。NEC 将在 2021 年度内标配于面部识别引擎「NeoFace」，将缩短活动现场和机场等处的面部识别的处理时间，提高便利性。(日经中文网)

全球前五大智能手机 华为 Q1 首度落榜

根据市调机构 IDC 初步资料显示，第一季全球智能型手机出货量超过 3.45 亿支，比去年同期激增 25.5%，中国与亚太地区是最大成长动能来源，而至第一季底实体清单禁令已施行半年，华为首度跌出全球前五大手机品牌之列，市占率遭到竞争对手 vivo、OPPO 与小米分食，三星则在新机效应下重回全球智能型手机出货量冠军。(中时新闻网)

Counterpoint 预测：2021 年全球 TWS 市场同比增长 33%

据 Counterpoint 全球可穿戴设备 (TWS) 市场预测 2021-2023，全球 TWS (真无线立体声耳机) 市场预计到 2021 年将同比增长 33%，达到 3.1 亿部。根据 Counterpoint 全球可穿戴设备 (TWS) 2020 年第四季度的市场追踪数据显示，尽管受到疫情引发的经济下滑影响，但 2020 年仍 TWS 同比增长了 78%。由于中低价位市场的强劲表现，该市场略微超出了 2020 年的最初年度估计，达到 2.33 亿部。(集微网)

全球 PC 市场(包括平板电脑)连续第 4 个季度强劲增长

来自 Canalys 的最新数据显示，全球 PC 市场(包括平板电脑)连续第 4 个季度强劲增长，出货量同比增长 53.1%，达到 1.221 亿台。随着我们进入 2021 年，Chromebook 和平板电脑继续表现出色，分别增长了 274.6% 和 51.8%，并在 1Q21 实现了可观的出货量，分别为 1,200 万和 3,970 万台。(闪信息)

苹果很可能会超过惠普，成为顶级的一体机 (AIO) PC 品牌供应商

据 Digitimes 报道，随着芯片和组件供应商优先考虑支持 iMac 等高端产品的发货，苹果很可能会超过惠普，成为顶级的一体机 (AIO) PC 品牌供应商。据称，由于组件短缺，一些 ODM 停止了许多 AIO PC 的生产，但 iMac 的生产仍然不受影响。(闪信息)

2、半导体

Omdia：2020 年显示驱动芯片需求旺：全年需求破 80 亿颗

市调机构 Omdia 日前发布最新调研报告称，受惠于“宅经济”蓬勃发展，去年显示驱动芯片的总需求量呈两位数同比增长，达 80.7 亿颗，大尺寸显示驱动芯片占总需求的 70%，其中仅液晶电视面板所用驱动芯片占大尺寸总需求的 40% 以上。在中小型显示驱动芯片市场，智能手机的市场份额最大。2020 年，包含液晶面板驱动芯片和 AMOLED 面板驱动芯片在内，占驱动芯片总需求的 20%。2021 年，IT 应用的增长仍然强劲，同时由于更高分辨率在电视面板中的渗透率提升，2021 年显示驱动芯片的总需求预计将增长至 84 亿颗。(国际电子商情)

SIA: Q1 全球半导体销售额季增 3.6%: 中国增长 25.6%

美国半导体行业协会 (SIA) 近日发布数据显示, 2021 年第一季度全球半导体销售总额为 1,231 亿美元, 比上一季度增长 3.6%, 比 2020 年第一季度增长 17.8%。2021 年 3 月, 全球销售额为 410 亿美元, 较上月增长 3.7%。中国 Q1 半导体销售额增长明显, 较去年同期增长 25.6%。(国际电子商情)

2026 年, GaN 电力市场将超过 10 亿美元

与 2019 年相比, GaN 电力市场在 2020 年翻了一番, 并有望在 2026 年超过 10 亿美元大关。作为对 GaN 市场增长的进一步证实, Yole 预测, 电信和数据通信以及汽车和移动市场将在中长期内为整体增长做出贡献, 这得益于 GaN 在快速充电器方面的提升。(Yole Reports)

IDC: 2021 年半导体将增长 12.5% 达到 5220 亿美元

据知名分析机构 IDC 报告显示, 2020 年全球半导体收入增长至 4,640 亿美元, 比 2019 年增长 10.8%。IDC 预测, 到 2021 年, 半导体市场将达到 5220 亿美元, 同比增长 12.5%。IDC 预计, 消费类、计算、5G 和汽车半导体将继续强劲增长。(半导体行业观察)

富士康成立半导体公司, 聚焦功率器件

5 月 5 日, 国巨与鸿海宣布, 双方将携手成立合资公司 - 国瀚半导体 (XSemi Corporation), 共同切入半导体相关产品的开发与销售, 将更深化双方在半导体领域的布局, 初期锁定平均单价低于美金 2 元的功率、模拟半导体产品, 简称小 IC, 进行多样的整合与发展。目前已和多家世界级半导体公司展开讨论, 近期将宣布相关半导体领域的合作案。(半导体行业观察)

全球硅晶圆出货突进 Q1 新高

据国际半导体产业协会 (SEMI) 旗下硅产品制造商组织 (Silicon Manufacturers Group, SMG) 发布最新一季晶圆产业分析报告, 2021 年第一季全球硅晶圆出货面积达 3337 百万平方英寸 (MSI), 创下季度出货的历史新高纪录, 较业界预期提早约 3 个季度, 显示硅晶圆市场景气已进入多头循环。(中时新闻网)

标准型 DRAM 合约价 4 月涨 25%

存储器市场供不应求, DRAM 及 NAND Flash 第二季合约价出现明显涨势, 其中, 4 月标准型 DRAM 合约价大涨逾 25%, 利基型 DRAM 合约价续涨 13~21%, 至于 SLC NAND 及 MLC NAND 合约价亦止跌回升 5~10% 幅度。(中时新闻网)

英特尔斥资 35 亿美元升级新墨西哥州工厂

英特尔首席执行官 Pat Gelsinger 表示, 该公司将斥资 35 亿美元升级其在新墨西哥州的工厂, 这是扩大该公司在国内制造业投资的计划的一部分。这笔支出加上 200 亿美元在亚利桑那州建立 2 个新工厂的计划, 是芯片制造商振兴其制造业的主要努力的一部分。(闪信息)

三星电子计划在平泽工厂提前 3 个月开始运营其 P3 半导体生产线

三星电子供应商 EcoPro HN 总裁表示, 由于全球芯片短缺, 三星电子计划在平泽工厂提前 3 个月开始运营其 P3

半导体生产线。三星本要求 EcoPro HN 在 2020 年 12 月之前提供其过滤器产品，而不是在 2022 年初之前的最后期限。（闪信息）

联咏：全产品线需求强到年底

驱动 IC 厂联咏副董事长王守仁表示，需求将一路强劲到年底，举凡智慧手机、电视及平板电脑等终端应用皆然。联咏对于第二季营运展望亦释出将再创新高的讯号，预期第二季营收将季增两成以上，加上毛利率将至少季增 1.4 个百分点至 45%，最高将冲上 48%，法人圈预期获利将持续冲出新高水准。（中时电子报）

3、汽车电子

日本财务省：中国对日本的纯电动汽车（EV）出口正在迅速增长

日本财务省的贸易统计显示，2021 年 1~3 月日本从中国进口的纯电动汽车数量为 879 辆，比去年同期的 96 辆增长了 9 倍。进口额增长了 48 倍，达到约 29.49 亿日元。2021 年 1~3 月的进口额已经超过了 2017~2020 年 4 年间的总额（约 17.38 亿日元）。（日经中文网）

Argo AI 声称其远程激光雷达传感器能够以高分辨率的逼真的质量看到 400 公尺的距离

Argo AI 声称其远程激光雷达传感器能够以高分辨率的逼真的质量看到 400 公尺的距离，并能够以低反射率检测黑暗和远处的物体。Argo 的测试车福特 Ford Fusion Hybrid 轿车和 Ford Escape Hybrid SUV 现在配备了这些激光雷达传感器。到 2021 年底，Argo 的测试车队将过渡到约 150 辆福特 Escape 混合动力汽车。福特计划在 2022 年部署自动驾驶汽车，用于乘车和送货。大众汽车则将在 2025 年开始商业运营。（闪信息）

三星发力汽车 MCU 代工

韩媒 businesskorea 报道，在三星晶圆代工厂的帮助下，韩国推出了首个用于汽车的自主 MCU 产品。报道指出，这个 32nm MCU 由韩国半导体设计公司 Telechips 开发。三星电子上个月开始了该芯片的试生产。（半导体行业观察）

大众将自研车用高性能微处理器

大众集团计划在内部设计和开发自动驾驶汽车的高性能微处理器，以及相关软件。首席执行官赫伯特·迪斯 (Herbert Diess) 在接受《商报》(Handelsblatt) 采访时解释了德国制造商管理未来移动所必需的一些部件的策略。（半导体行业观察）

电动车销量翻倍！大众 2021 第一季度营业利润大涨 433%

得益于销量上涨和产品阵容有所改善，大众第一季度营收上涨 13.3% 至 624 亿欧元；虽然处于疫情时期和受到了半导体短缺的轻微影响，但大众营业利润仍大涨 433% 至 48 亿欧元；销售营业利润率为 7.7%，去年同期仅为 1.6%；税前利润从 7 亿欧元激增至 45 亿欧元。汽车部门调整后净现金流高达 55 亿欧元，去年同期则为负 15 亿欧元，净流动性资产涨至 296 亿欧元。大众集团首席财务官 Arno Antlitz 表示：“整个汽车业的半导体短缺预计将在第二季度产生更严重的影响，不过，我们对全年业务发展有信心，因此上调了预期。”（盖世汽车）

福特 Q1 净利润创十年新高，全年或因缺芯损失 25 亿美元

福特汽车公布其 2021 年第一季度财报，净利润创下 10 年来新高。不过福特同时警告称，由于芯片短缺导致一些高利润车型的装配线停产，第二季度可能会损失一半计划中的产量。（盖世汽车）

4、面板/LED/PCB 等

日亚化 (Nichia) 次世代 mini LED

日亚化 (Nichia) 次世代 mini LED，锁定桌上型显示器、笔记型电脑、平板电脑、头戴式显示器等应用领域，目前已经开始交货给笔电厂，为此，日亚化在日本德岛投资 600 亿日元(5.49 亿美元)进行扩产，目前月产能约 5 万颗，估 2023 年可望攀升至 200 万颗，日亚化借此宣示，跨入 mini LED 市场。（闪信息）

抢攻 Mini LED 背光市场，日亚化推出新产品

日亚化学股份有限公司 5 日发布以创新及高技术能力所开发出来的高差异化的新型 Mini LED 光源。与以往的 Mini LED 光源相比，日亚化光源可以在极低的耗电下达到全画面 1,000nits 的亮度；而局部画面范围，则可以达到 2,000nits 的超高亮度。另外，1,000 分区的局部点亮，可以达到 1,000,000: 1 的对比（明暗差，数值越大画质就越鲜明）。（LED inside）

清华大学成功开发叠层 RGB Micro LED 全色阵列

近日，清华大学电子工程系盛兴研究组开发了一种基于叠层式红、绿、蓝三色（RGB）微型发光二极管（Micro LED）的器件阵列设计，可用于全彩色照明和显示。该研究通过探索外延剥离和转移印刷技术，实现了基于不同单晶 III-V 族半导体的薄膜 Micro LED 在垂直方向上的异质集成。同时，通过设计具有波长选择透过的光学薄膜作为 Micro LED 之间的界面层，提高了器件的发光效率和辐射性能。这种新颖的策略能够实现可见光全覆盖的可独立寻址控制的动态图案化显示，为下一代新型显示系统提供新的途径。（LED inside）

湖北三安光电 Mini/Micro LED 项目一期建设完成、4 月开始试产

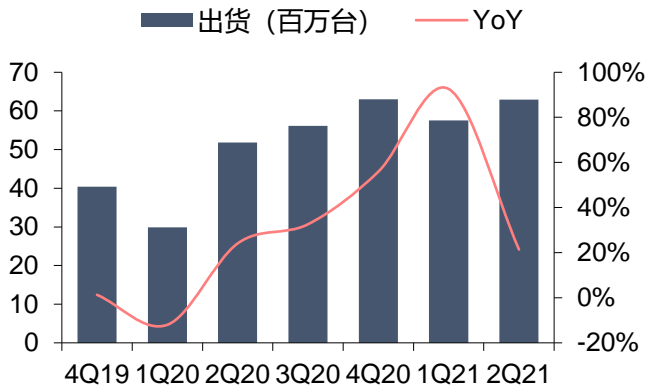
三安光电 Mini/Micro 显示产业化项目于 2019 年 4 月签约，同年 11 月开工建设。今年 4 月 16 日，湖北三安光电项目第一批晶圆片正式投料。项目一期计划投资 55 亿元，主要新建厂房、生产附属用房及配套生活设施。截止 2021 年 4 月底，累计完成投资 31.9 亿元，一期已建设完成，并于 2021 年 4 月开始试产。（集微网）

隆利科技预计今年 Mini-LED 车载产线开始释放产能

隆利科技在业绩说明会上表示，公司于 2016 年已经开始 Mini-LED 技术研发，并于 2018 年完成试产线的投入并顺利运行，2020 年通过募集约 1.8 亿加码投资 Mini-LED 产品产能，其中车载布局 10 条线，目前已经具备量产能力。2020 年上半年已经实现小批量出货。预计 2021 年 Mini-LED 车载产线将开始释放产能。因此，公司目前已经具备智能座舱显示产品的定制化开发能力和生产能力，2021 年将持续加大在智能座舱领域的布局。（集微网）

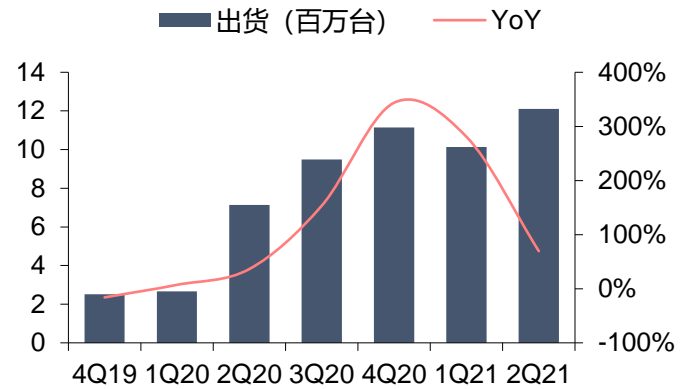
附录三：近期重要行业数据整理更新

图 7：4Q19-2Q21 全球 NB 出货量变化与预测



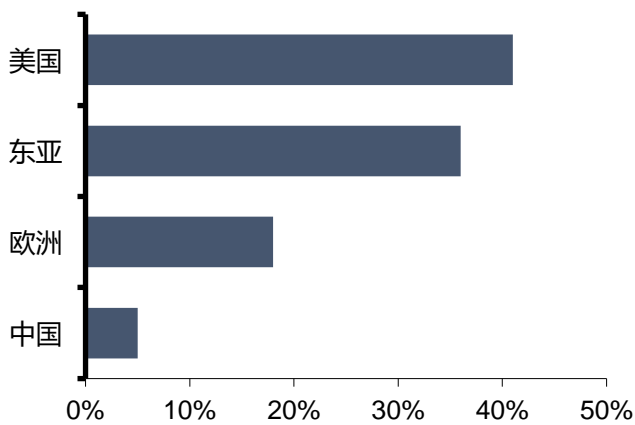
资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 8：4Q19-2Q21 全球 Chromebook 出货量变化与预测



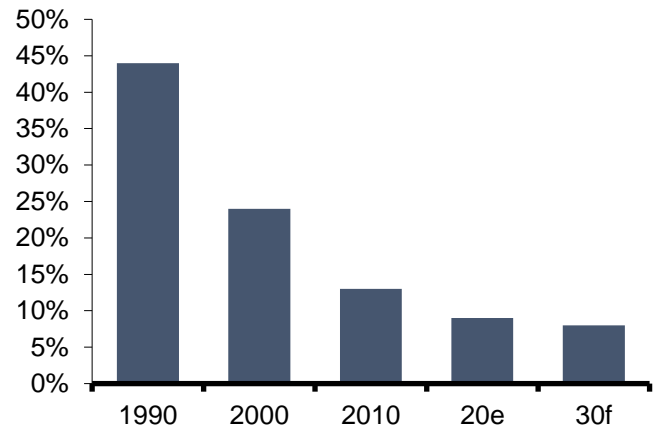
资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 9：全球各区域半导体设备市场比重



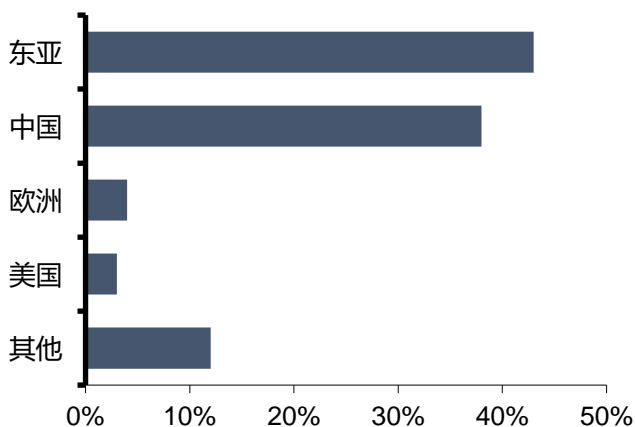
资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 10：欧洲 30 年来半导体制造产能全球占比



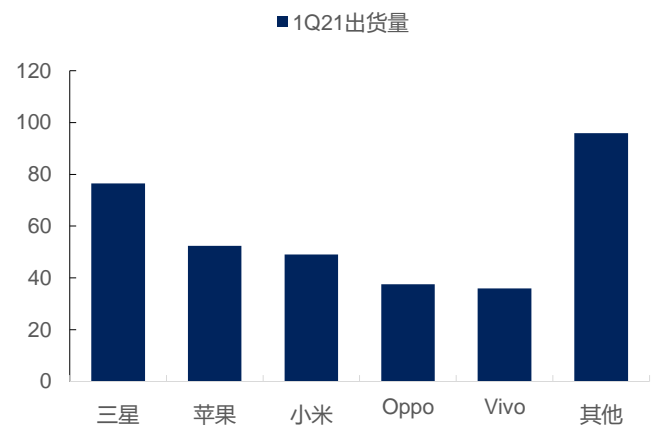
资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 11：全球各区域封测市场比重

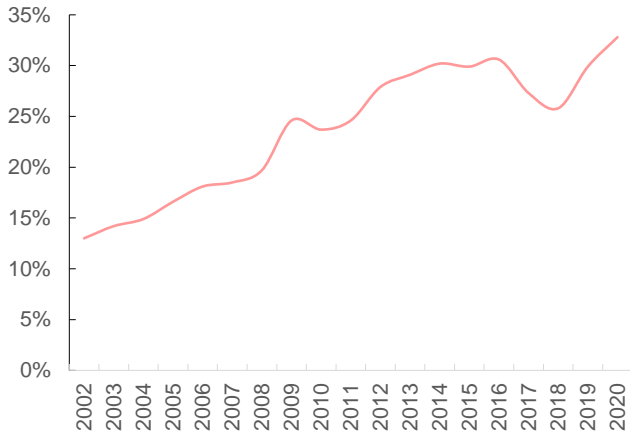


资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

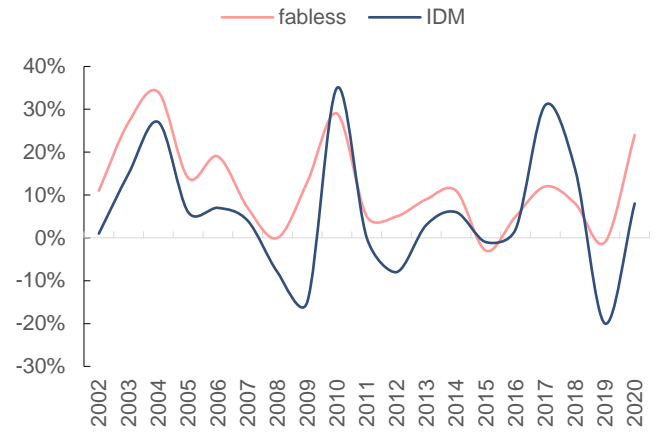
图 12：1Q21 全球智能手机出货 Top 5 (百万支)



资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 13: 全球 Fabless 厂商营收占比趋势


资料来源: Digitimes, 信达证券研发中心

图 14: 全球 Fabless 厂商及 IDM 厂商营收增速对比


资料来源: Digitimes, 信达证券研发中心

附录四：上市公司重要公告和未来大事提醒

【精测电子】发布了关于收到政府补助的公告。公司及多家子公司自 2021 年 1 月 1 日至本公告披露日累计获得各项政府补助资金共计人民币 4937.74 万元，其中与收益相关的政府补助收入共计 1937.74 万元，与资产相关的政府补助收入共计 3000 万元。

【三利谱】发布了减持股份计划的预披露公告。董事长张建军计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式或自本公告发布之日起 3 个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份，减持股份数量合计不超过 760 万股，即不超过公司股份总数的 4.37%。

【三安光电】发布了部分股份解除质押的公告。控股股东三安集团将其质押给芯鑫商业保理(天津)有限责任公司的 2109 万股股份办理解除质押手续。本次解除质押后，三安集团持有公司股份累计质押数量为 7530 万股，占其所持有公司股份的 30.91%。

【领益智造】发布了部分股份质押及解除质押的公告。控股股东领胜投资已将其所持 8334 万股质押给华泰资管；及领胜投资已将其持有并质押给国信证券的 2.36 亿股办理解除质押。

【晶丰明源】发布了 2020 年限制性股票激励计划授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告。本次归属的限制性股票数量为 43.01 万股，占归属前公司总股本的比例为 0.70%。

【华峰测控】发布了《2020 年限制性股票激励计划(草案)》。公司 2020 年限制性股票授予条件已经成就，公司确定 2021 年 4 月 30 日为授予日，以人民币 98.14 元/股的授予价格向 8 名激励对象授予 4.50 万股限制性股票。

【中芯国际】发布了《关于非执行董事辞任的公告》，非执行董事路军因工作安排调整，辞任本公司第二类非执行董事以及董事会提名委员会委员的职务，自 2021 年 4 月 29 日起生效。

【乐鑫科技】发布了《2019 年及 2020 年第一期限限制性股票激励计划部分归属结果暨股份上市公告》。本次归属股票数量:6.14 万股，占归属前公司总股本的比例为 0.0768%。本次归属股票上市流通时间:2021 年 5 月 10 日。

【闻泰科技】发布了《关于股东减持进展》的公告，公司股东云南省康旅控股集团有限公司(简称“康旅集团”)、云南融智投资有限公司(简称“云南融智”)通过集中竞价方式累计减持公司股份 1242.5 万股，占公司目前总股本的 0.998%。本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

【韦尔股份】发布了《关于收到中国证监会上海证监局警示函的公告》。因公司在信息披露方面存在问题，上海证监局决定对公司采取出具警示函的监管措施。

研究团队简介

方 竞，西安电子科技大学本硕连读，近 5 年半导体行业从业经验，有德州仪器等外企工作经历，熟悉半导体及消费电子产业链。同时还是国内知名半导体创业孵化平台 IC 咖啡的发起人，曾协助多家半导体公司早期融资。2017 年在太平洋证券，2018 年在招商证券，2020 年加入信达证券，任电子行业首席分析师。所在团队曾获 19 年新财富电子行业第 3 名；18/19 年《水晶球》电子行业第 2/3 名；18/19 年《金牛奖》电子行业第 3/2 名。

李少青，武汉大学硕士，2018 年加入西南证券，2020 年加入信达证券，覆盖半导体产业链。

刘志来，上海社会科学院金融硕士，2020 年加入信达证券，覆盖消费电子产业链。

童秋涛，复旦大学资产评估硕士，2020 年加入信达证券，从事电子行业研究。

机构销售联系人

区域	姓名	手机	邮箱
全国销售总监	韩秋月	13911026534	hanqiuyue@cindasc.com
华北副总监 (主持工作)	陈明真	15601850398	chenmingzhen@cindasc.com
华北	卞双	13520816991	bianshuang@cindasc.com
华北	阙嘉程	18506960410	quejiacheng@cindasc.com
华北	刘晨旭	13816799047	liuchexu@cindasc.com
华北	欧亚菲	18618428080	ouyafei@cindasc.com
华北	祁丽媛	13051504933	qiliyuan@cindasc.com
华北	魏冲	18340820155	weichong@cindasc.com
华东副总监 (主持工作)	杨兴	13718803208	yangxing@cindasc.com
华东	吴国	15800476582	wuguo@cindasc.com
华东	国鹏程	15618358383	guopengcheng@cindasc.com
华东	李若琳	13122616887	liruolin@cindasc.com
华东	孙斯雅	18516562656	sunsiya@cindasc.com
华东	张琼玉	13023188237	zhangqiongyu@cindasc.com
华南总监	王留阳	13530830620	wangliuyang@cindasc.com
华南	陈晨	15986679987	chenchen3@cindasc.com
华南	王雨霏	17727821880	wangyufei@cindasc.com
华南	王之明	15999555916	wangzhiming@cindasc.com
华南	闫娜	13229465369	yanna@cindasc.com
华南	焦扬	13032111629	jiaoyang@cindasc.com
华南	江开雯	18927445300	jiangkaiwen@cindasc.com
华南	曹曼茜	18693761361	caomanqian@cindasc.com

分析师声明

负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明，本人具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告；本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点；本人薪酬的任何组成部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关。

免责声明

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本报告由信达证券制作并发布。

本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。客户应当认识到有关本报告的电话、短信、邮件提示仅为研究观点的简要沟通，对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制，但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会出现不同程度的波动，涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，致使信达证券发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告，对此信达证券可不发出特别通知。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

在法律允许的情况下，信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务。

本报告版权仅为信达证券所有。未经信达证券书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若信达证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，信达证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。

如未经信达证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。信达证券将保留随时追究其法律责任的权利。

评级说明

投资建议的比较标准	股票投资评级	行业投资评级
本报告采用的基准指数：沪深 300 指数（以下简称基准）； 时间段：报告发布之日起 6 个月内。	买入 ：股价相对强于基准 20% 以上；	看好 ：行业指数超越基准；
	增持 ：股价相对强于基准 5%~20%；	中性 ：行业指数与基准基本持平；
	持有 ：股价相对基准波动在±5% 之间；	看淡 ：行业指数弱于基准。
	卖出 ：股价相对弱于基准 5% 以下。	

风险提示

证券市场是一个风险无时不在的市场。投资者在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事。

本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业顾问的意见。在任何情况下，信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。